

世界最大級の組込み専門技術展&カンファレンス

■パビリオン

オープンイノベーションを加速する パビリオンを開設します！

産業分野を超える拡大するビジネスフィールドに向け、中小・ベンチャー企業、大学等研究・教育機関を対象に技術シーズ、革新的な製品、サービス／ソリューション、アイディア等価値ある出会いを創出するパビリオンです。

ベンチャー/スタートアップ

下記①・②の両方を満たす企業を対象とさせていただきます。
①組込み技術およびIoT技術に関するベンチャー企業、スタートアップ企業が対象。
②ET/IoT展への出展回数が3回以下。

ユニバーシティ

組込み技術およびIoT技術に関する研究、教育、技術移転等を行う大学等研究・教育機関を対象としたパビリオン。

設計開発サービス

受託開発および設計資産提供等の企業を対象としたパビリオン。

電子設計・EDA

ハードウェア開発環境(EDA)、EDA/LSI設計関連ツール、設計サービス関連(ESL/PCB)等、EDAに関連する製品・技術を扱っている企業を対象としたパビリオン。

■出展サポートプログラム

貴社ブースへの来場者誘導から出展社セミナーまでサポート

ベーシック【無料】(予定)

- 来場案内セット／ポスターの無料配布
- 公式ホームページへの出展社情報掲載
- 特別招待者プログラム
- 出展社専用Webサイト
- 新規出展社をホームページで紹介
- 公式ホームページへの出展社プレスリリース掲載／プレスルームへの資料設置
- 来場者プレゼント協賛
- 公式ホームページでの新製品／小間内プレゼンテーション／デモ紹介

オプション【有料】(予定)

- ◎出展社セミナー
 - プライベートカンファレンス
1日または半日単位で開催可能な独自セミナーの実施をサポート(アネックスホールまたは会議センターをご提供)
 - オープンステージプレゼンテーション
展示会場内のメインステージをご提供(1ステージ20分)
- ◎会場広告
 - コンコースバナー
 - 柱巻き看板広告
 - エスカレータ上部バナー
 - クイーンズ橋街路灯フラッグ
 - 会場案内図＆会場入口案内掲示板広告
 - ロゴ入りネックストラップ
 - 会場内天井吊りバナー【NEW】
- ◎ネット広告
 - 公式ホームページバナー
 - メール配信「ET/IoT Technology Mail News」での出展社広告配信

■開催までのスケジュール

2017年4～5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月 13-14-15-17
★ 出展申込受付	★ 出展申込締切日 6月30日(金)※1		★ 出展説明会※2 9月上旬	★ 来場案内配布 10月上旬	搬入・設営日	展示会開催
		★ 出展社専用 Webサイト開設 8月上旬				

＜申込方法＞

別紙の出展申込書に必要事項をご記入・ご捺印の上、事務局にお送りください。

(※1)ただし、定数になり次第締め切らせていただきます。

(※2)出展要項および出展サポートプログラム詳細についての説明、会場仕様と小間割の発表などを行います。

お申し込み
お問い合わせ

ET/IoT Technology 事務局

(株式会社JTBコミュニケーションデザイン内)

〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
TEL.03-5657-0756 FAX.03-5657-0645 e-mail:etinfo@jasa.or.jp

公式サイト

<http://www.jasa.or.jp/expo/>



組込み総合技術展 Embedded Technology 2017

同時開催

IoT Technology 2017

主 催：一般社団法人組込みシステム技術協会(JASA)
企画・推進：株式会社JTBコミュニケーションデザイン

申込期限 2017年6月30日(金)



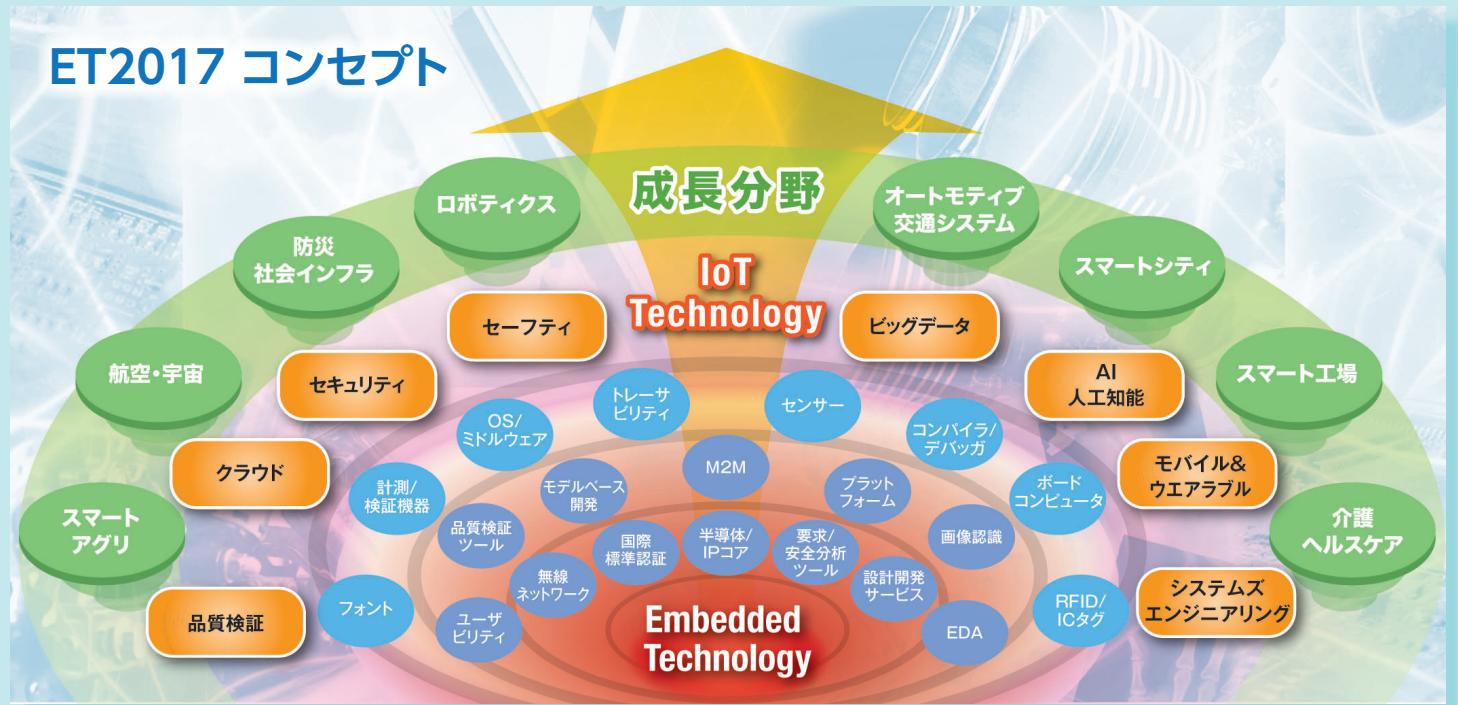
出展案内

11.15 水 WED - 17 金 FRI 10:00～17:00
[16日(木)は18:00まで]

会場: パシフィコ横浜 展示ホール及び会議センター

<http://www.jasa.or.jp/expo/>

ET2017 コンセプト



進化する組込み技術!成長分野を支える
最先端技術とソリューションをアピール

績

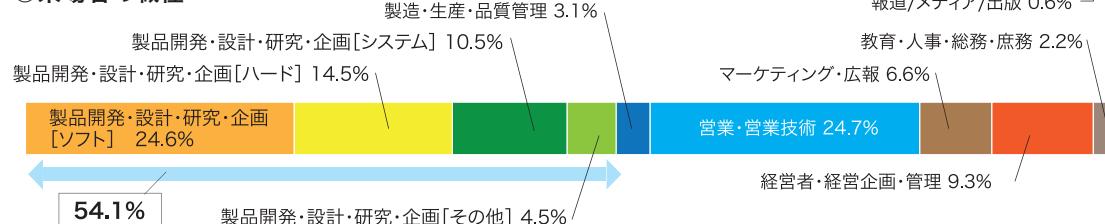
●来場者数 25,654名 ●出展社数 415社・団体 ●小間数 809小間

目的意識の高い技術者、マネジメント層を中心にご来場いただいているます!!

◎来場者の業種



◎来場者の職種



カンファレンス

●2016 受講者数 11,695名 ●2016 プログラム数 102セッション
(プライベートカンファレンスを含む)

出展品目

- IoT向け半導体デバイス
- 各種センサー/M2M技術
- 遠隔監視・制御システム
- センシング技術
- ワイヤレスネットワーク(SIGFOX, LoRaWAN, NB-IoT, Wi-SUN, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, NFCなど)
- ウエアラブル関連機器

- ITS関連システム
(車載ネットワーク、交通管理システムなど)
- データ分析・解析技術/計測・測定技術
- IoT向けプラットフォーム設計技術
- セキュリティ/認証技術
- スマートエネルギー関連技術
(ワイヤレス電力伝送、スマートメーターなど)

IoT Technology2017

- IoT向けインテグレーションサービス
- 各種認証取得サービス(無線認証など)

テーマゾーン
重点テーマとして
カンファレンスと
連動



特に注目が高まるAI、セキュリティ、センサー分野にフォーカスしたゾーンをご用意しました。

組込みAI活用

IoT時代のキーとなるAI技術。Embedded/IoTデバイス側でのAIを活用した技術・サービスの集中展示エリア

リアルタイム性、省電力、エッジコンピューティング etc.



組込みシステムの脆弱性とリスクが問われる時代です。
こちらではデバイスセキュリティにスポットをあてた展示エリア



IoT時代に向けたセンシング技術が求められています。
用途・目的に応じた様々なセンシング技術にスポットをあてた展示エリア



時代の流れとともに進化し続ける無線技術。こちらでは最新の無線通信規格から対応デバイスなどの集中展示エリア

SIGFOX, LoRaWAN, NB-IoT, Wi-SUN etc.

出展品目

- ハードウェア・ソリューション
CPU / MCU, DSP, 映像・画像処理技術、SoC, ASSP / ASIC, メモリモジュール、SSD, IPコア, FPGA / PLD, メディアプロセッサ, アナログIC(電源用, A/D, D/A等)、パワー半導体、有線/無線ネットワーク (SIGFOX, LoRaWAN, NB-IoT, WiFi, Bluetooth, ZigBee等)通信インターフェース(HDMI, USB等)、NFC, RFID/ICタグ 他

- ソフトウェア・ソリューション
リアルタイムOS、組込みLinux, Android, デバイスドライバ、ファームウェア、ミドルウェア、コーデック 他
- 開発環境・ツール
開発支援ツール、言語系(C/C++, Java, HTML/XML, UML, SysML, コンパイラ/アセンブラー等)、デバッグツール(ICE, エミュレータ、デバッガ、シミュレータ等)、
- インテグレーション/デザインサービス/関連企業・団体
受託開発/コンサルティング、品質検証サービス、ROM/Flash プログラミングサービス 他

ET2017

出展要項 申込期限 2017年6月30日(金)

●出展料
通常出展/
テーマゾーン(AI/無線技術/セキュリティ/センシング)
1小間(3m×3m=約9m²)

単列小間(1~3小間) 一般: 464,400円(税込)
会員: 410,400円(税込)

複列小間(4小間以上) 一般: 442,800円(税込)
会員: 388,800円(税込)

※会員とは一般社団法人組込みシステム技術協会の会員企業を指します。

●小間仕様
○他社の出展スペースと隣接する場合は、接続面に基礎壁面を設置いたします。
○10小間以上は単独の島小間となり壁面は設置されません。

参考>通常出展パッケージブース(有料)
事務局では、出展社の皆様の出展サポートとして、低成本のパッケージブースプラン及び、各展示用レンタル備品をご用意しております。皆様の出展のご検討とあわせまして、出展費用算出のご参考としてご確認ください。

スタンダードプラン 1小間(3m×3m=約9m²)
セット価格: ¥108,000(税込)



※上記の他にも小間数に応じた多様なデザインをご用意しております。